

证书号第10653885号



# 实用新型专利证书

实用新型名称：一种芯片封装结构

发明人：梁德强

专利号：ZL 2019 2 2280408.X

专利申请日：2019年12月17日

专利权人：江苏爱矽半导体科技有限公司

地址：221000 江苏省徐州市徐州经济技术开发区凤凰湾电子信息产业园A9、A10号厂房

授权公告日：2020年06月02日

授权公告号：CN 210668353 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长  
申长雨

申长雨



第1页(共2页)

其他事项参见续页

证书号第10653885号



专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年12月17日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

江苏爱矽半导体科技有限公司

发明人：

梁德强